

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：1107

講演題目：浮遊選鉱法により改質したフライアッシュを用いたセメントペーストの水和反応と養生温度の検討

誤	正
2 ページ目 図 4 のキャプション 図 4 C-S-H 存在量と圧縮強度	図 4 C-S-H 存在量

以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号 : 1108

講演題目 : フライアッシュセメントにおけるフライアッシュ反応層の観測およびシミュレーションによる推定

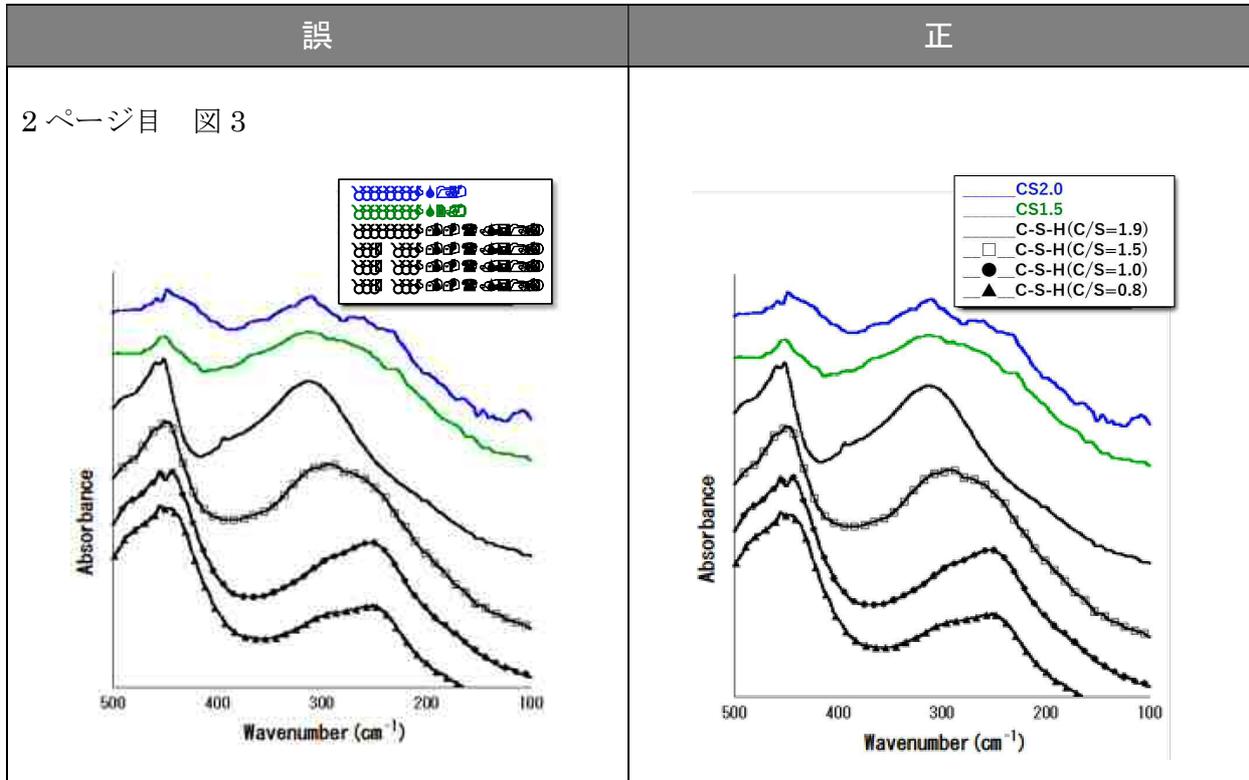
誤	正																																																																						
<p>1 ページ目 右段 上から 7 行目</p> <p>表 1 フライアッシュの物性</p> <p style="text-align: center;">(空白)</p> <p>表 2 図 1 のシミュレーションに用いた反応係数</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2 行 5 列の表</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">5 行 3 列の表</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								2 行 5 列の表															5 行 3 列の表													<p>表 1 フライアッシュの物性</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2 行 5 列の表</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>表 2 図 1 のシミュレーションに用いた反応係数</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">5 行 3 列の表</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								2 行 5 列の表															5 行 3 列の表												
		2 行 5 列の表																																																																					
		5 行 3 列の表																																																																					
		2 行 5 列の表																																																																					
		5 行 3 列の表																																																																					

以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：1110

講演題目：錯体重合法による C-S-H の合成と高比表面積 β -C₂S の作製および
その水和性状に関する検討



以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：1205

講演題目：セメントペースト中の超吸水性ポリマーの吸水能の推定

誤	正
2 ページ目 左段 上から 2 行目 約 250 個	約 700 個
2 ページ目 左段 上から 8 行目 2710 μ m	2600 μ m
2 ページ目 左段 上から 10 行目 25.9%	31.6%
2 ページ目 左段 上から 12 行目 38.8g/g	47.5g/g
2 ページ目 右段 上から 4 行目 38.8g/g	47.5g/g
2 ページ目 右段 上から 5 行目 3.8 倍	4.1 倍
2 ページ目 右段 上から 10 行目 2710 μ m 3.2 倍	2600 μ m 3.0 倍
2 ページ目 右段 第 2 段落 2 行目 38.8g/g	47.5g/g
2 ページ目 右段 第 2 段落 3 行目 2470 μ m	2600 μ m
2 ページ目 右段 第 2 段落 5 行目 4.9 個	5.3 個

誤	正
<p>2 ページ目 右段 第2段落6行目</p> <p>5.8 個</p>	<p>14.8 個</p>
<p>2 ページ目 右段 第2段落最後の3行</p> <p>…エッジ補正を行っていないことを考慮すると、…みなせるようである。</p>	<p>エッジ補正を行っていないことを考慮したとしても、この個数差は練り混ぜ中の粒子の破壊を示唆している。</p>
<p>2 ページ目 右段結論 下3行</p> <p>また、その推定値は…示した。</p>	<p>また、断面に現れた SAP 粒子数から、SAP 粒子の練り混ぜ中の破壊が示唆された。</p>

以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：1307

講演題目：実効拡散係数迅速測定のための電気泳動法についての電気化学的考察

誤	正
2 ページ目 左段 上から 25 行目 一定速度	一定流束
2 ページ目 左段 上から 27 行目 $\frac{dx_{\pm}}{dt} = J_{\pm}$	$\frac{dx_{\pm}}{dt} = J_{\pm} / C_0$

以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：2310

講演題目：セメント系安定処理粘土の力学特性－初期せん断弾性係数の拘束圧依存性－

誤	正
<p>2 ページ目 参考文献</p> <p>1) 山田雅一ほか:セメント系安定処理粘土の初期せん断剛性に関する検討、セメント・コンクリート論文集、Vol. 71、Vol. 1、pp. 639-644 (2017)</p>	<p>1) 山田雅一ほか:セメント系安定処理粘土の初期せん断剛性に関する検討、セメント・コンクリート論文集、Vol. 71、No.1、pp. 639-644 (2017)</p>

以 上

第 73 回セメント技術大会 講演要旨正誤表

講演番号：3208

講演題目：モノカーボネート存在下における C-S-H の生成・共存がエトリングイト二次生成に及ぼす影響

誤	正
1 ページ目 著者欄 2 行目 「工学部工学科社会基盤工学プログラム」	「工学部工学科社会基盤工学プログラム」
1 ページ目 左段 上から 2 行目 「近年、エトリングイトの二次生成によるコンクリートの膨張」(フォント 9.5)	「近年、エトリングイトの二次生成によるコンクリートの膨張」(フォント 10.5)
2 ページ目 左段 上から 24 行目、26 行目 「paring site」	「pairing site」

以上